

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-135632

(43)Date of publication of application : 10.05.2002

(51)Int.CI.

H04N 5/225

H01L 21/60

H01L 27/14

H04N 5/335

(21)Application number : 2000-320001

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing : 19.10.2000

(72)Inventor : YODA TOSHIYUKI

KIDA SUSUMU

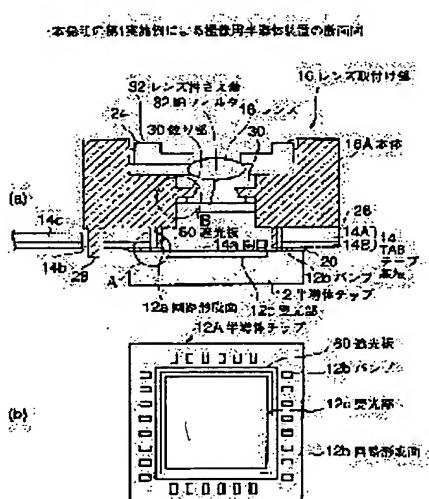
SUZUKI HIDEO

(54) SEMICONDUCTOR DEVICE FOR IMAGING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device for imaging the thickness and the area, of which are smaller than those of the conventional devices concerning the semiconductor device for imaging obtained by packaging a semiconductor element having a photodetector and a lens for imaging.

SOLUTION: A lens-fitting part 16, having the lens for imaging 18 fitted thereto, is fitted to a TAB tape board 14. A semiconductor chip for imaging 12 is mounted on a side opposite to the part 16. The lens 18 and the photodetector of the chip 12 face each other via an opening 14a formed at the substrate 14. Light, advancing toward the chip 12 via the substrate 14, is cut off by a light-shielding plate 60 to exclude influence on the photodetector substantially.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 15.06.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The lens installation section in which the lens for an image pick-up was attached, and the semiconductor chip with which the photo detector which changes the light from said lens for an image pick-up into a picture signal was formed in the circuit forming face, The substrate which has the flexibility which supplies the picture signal which was established between said lens installation sections and said semiconductor chips, and was generated with said semiconductor chip to an external circuit, The semiconductor device for an image pick-up characterized by intercepting the light which penetrates this substrate and faces to said semiconductor chip, and having the gobo from which the effect on said photo detector is removed substantially.

[Claim 2] Said photo detector which it is a semiconductor device for an image pick-up according to claim 1, said semiconductor chip was mounted in said substrate after said circuit forming face had turned to said substrate, and was formed in said circuit forming face is a component for an image pick-up characterized by having countered with said lens for an image pick-up through opening prepared in said substrate.

[Claim 3] Said lens installation section is a semiconductor device for an image pick-up characterized by being fixed to the field of the opposite hand of the field of said substrate with which said semiconductor chip was mounted in the condition that are a semiconductor device for an image pick-up according to claim 1 or 2, said lens installation section has the gage pin, said substrate has tooling holes, and said gage pin fitted into said tooling holes by adhesives.

[Claim 4] It is the semiconductor device for an image pick-up characterized by being a semiconductor device for an image pick-up given in any 1 term claim 1 thru/or among 3, and said gobo having extended toward said semiconductor chip from said lens installation section in opening of said substrate.

[Claim 5] It is the semiconductor device for an image pick-up characterized by being a semiconductor device for an image pick-up according to claim 4, and forming said gobo with the ingredient which has elasticity, and the head being in contact with said circuit forming face of said semiconductor chip.

[Claim 6] It is the semiconductor device for an image pick-up which it is a semiconductor device for an image pick-up according to claim 2, and said gobo is formed in said lens installation section in one, and is characterized by fixing the head of said gobo to said circuit forming face of said semiconductor chip by adhesives.

[Claim 7] The edge of said converging section which it is a semiconductor device for an image pick-up given in any 1 term claim 1 thru/or among 6, and said lens installation section has the converging section which forms opening which acts as drawing to said lens for an image pick-up, and forms this opening is a semiconductor device for an image pick-up characterized by being the inclined plane which carried out predetermined include-angle dip to the optical axis of said lens for an image pick-up.

[Claim 8] It is the semiconductor device for an image pick-up which is a semiconductor device for an image pick-up given in any 1 term claim 1 thru/or among 7, and is characterized by for said substrate having the wiring drawer section for connecting with an external circuit, and carrying electronic parts in this wiring drawer section.

[Claim 9] The lens installation section in which the lens for an image pick-up was attached, and the

semiconductor chip with which the photo detector which changes the light from said lens for an image pick-up into a picture signal was formed. It is the semiconductor device for an image pick-up which has the substrate with which said semiconductor chip was mounted. Said lens installation section It has the upper part in which said lens for an image pick-up was attached, and the lower part fixed to said substrate. It is the semiconductor device for an image pick-up which said upper part is constituted movable in the direction approached or estranged to said substrate to said lower part, and is characterized by the distance between said lenses for an image pick-up and said semiconductor chips being adjustable.

[Claim 10] The semiconductor device for an image pick-up which is a semiconductor device for an image pick-up according to claim 9, and is characterized by having escaped so that said upper part might not separate from said lower part, and establishing a stop device when said upper part moves in the direction estranged from said substrate.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] Especially this invention relates to the semiconductor device for an image pick-up which packed the semiconductor device which has a photo detector, and the lens for an image pick-up with respect to the semiconductor device for an image pick-up.

[0002] In recent years, the portable telephone and handy personal computer (pocket mold personal computer) with which the miniature camera was incorporated are developed. For example, the portable telephone equipped with the miniature camera picturizes a call person's image with a miniature camera, incorporates it as image data, and transmits the image data to a call partner. Generally such a miniature camera is constituted by a C-MOS sensor and the lens.

[0003] The miniaturization is demanded also of the miniature camera with which miniaturization with much more portable telephone and handy personal computer is advanced, and is used for these. In order to satisfy the demand of the miniaturization to such a camera, the semiconductor device package which unified and formed the lens and the C-MOS sensor is developed.

[0004]

[Description of the Prior Art] The Japanese-Patent-Application-No. No. 17997 [11 to] official report is indicating the semiconductor device package of a configuration of having unified the lens for an image pick-up and the semiconductor chip which has a C-MOS sensor. In this semiconductor device package, that light-receiving side is carried in the condition of having been upwards suitable, on the printed circuit board which has rigidity, and wirebonding of the semiconductor chip which has a C-MOS sensor is carried out to the printed circuit board. The lens for an image pick-up is being fixed to the printed

circuit board so that it may be arranged at the position above the light-receiving side of a semiconductor chip. Therefore, the semiconductor device package for the conventional miniature cameras indicated by the Japanese-Patent-Application-No. No. 17997 [11 to] official report is the configuration that a semiconductor chip is carried on a substrate and a lens is arranged on it.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] The semiconductor device package of an above-mentioned configuration originates in the structure, and has the following problems.

[0006] 1) In the manufacture process of a semiconductor chip in which it has a photo detector, in order to make thickness of a semiconductor chip small, the tooth back of a semiconductor chip is deleted with the grinder. For this reason, the thickness of a semiconductor chip is changed for every wafer. Although the range of about **30 micrometers of fluctuation is usually about **15 micrometers, there is as tolerance. Fluctuation of the thickness of a semiconductor chip will fluctuate the distance between the light-receiving side of a semiconductor chip, and a lens. That is, since a lens is arranged from the front face of a printed circuit board at a predetermined distance and the light-receiving side of a semiconductor chip is arranged in the location distant from the front face of a printed circuit board by the thickness of a semiconductor chip, if the thickness of a semiconductor chip increases, a light-receiving side will approach a lens, and if the thickness of a semiconductor chip decreases, a light-receiving side will keep away from a lens.

[0007] The distance between a lens and the light-receiving side of a semiconductor chip is set up equally to the focal distance of a lens, and an image with a lens carries out image formation to accuracy in respect of light-receiving. Therefore, if the distance between a lens and a light-receiving side is changed as mentioned above, a focal gap will occur and the problem that an image fades will occur.

[0008] 2) In case a semiconductor chip is carried in a printed circuit board, using dice attachment equipment, paste up a semiconductor chip on the surface of a printed circuit board, and fix. With dice attachment equipment, the front face (field in which the photo detector was formed) of a chip is adsorbed, and is held, and it conveys and lays on a printed circuit board. For this reason, the front face of a semiconductor chip will be covered with an adsorber, and cannot carry out the image recognition of the field in which the photo detector was formed. Therefore, the image recognition of the appearance of a semiconductor chip is carried out, and this appearance is made into the criteria for positioning a semiconductor chip on a printed circuit board. However, the physical relationship with not necessarily fixed the light-receiving side and appearance of a semiconductor chip has not become. That is, a semiconductor chip is piece[of an individual]-ized by carrying out the dicing of the wafer and dividing it. Although the appearance of a semiconductor chip is formed in that case, when changing the cutting location by dicing, the location of the light-receiving side over the appearance of a semiconductor chip is not fixed. Therefore, the focal location of a lens may not be in agreement with accuracy at the core of a light-receiving side.

[0009] 3) Since a semiconductor chip is carried in a printed circuit board by wirebonding, it must arrange the pad for wirebonding around a semiconductor chip. Therefore, it is necessary to prepare the part which arranges a bonding pad in a printed circuit board, and has become the hindrance of a miniaturization of a semiconductor device package.

[0010] 4) Required thickness is the distance which applied the thickness of a semiconductor chip to the focal distance of a lens substantially as a semiconductor device package. However, with the above-mentioned conventional semiconductor device package, since the printed circuit board is arranged in the opposite hand of the lens of a semiconductor chip, the actual thickness of a semiconductor device package serves as distance which applied the thickness of a printed circuit board to the distance which applied the thickness of a semiconductor chip to the focal distance of a lens further. Therefore, the thickness of a semiconductor device package is increasing by the thickness of a printed circuit board.

[0011] 5) The printed circuit board is formed with the ingredient which has the rigidity of the ceramics or glass epoxy. Therefore, a printed circuit board cannot be crooked, but in case it builds a

semiconductor device package into a device, it has the problem that the degree of freedom of arrangement is small. That is, in order to connect to the main substrate in a portable telephone or a handy personal computer electrically the semiconductor device package which forms a miniature camera, a package is mounted in a direct main substrate, or there is constraint that it is necessary to form a flexible wiring substrate between the main substrate and a semiconductor device package. Such constraint makes low the degree of freedom of a case design of a portable telephone or a handy personal computer.

[0012] This invention is made in view of the above-mentioned point, its thickness is conventionally smaller than equipment, and it sets it as the main objects to offer the packed semiconductor device for an image pick-up also with a small area.

[0013]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned technical problem, in this invention, it is characterized by providing each means expressed below.

[0014] The lens installation section in which invention according to claim 1 is a semiconductor device for an image pick-up, and the lens for an image pick-up was attached, The semiconductor chip with which the photo detector which changes the light from said lens for an image pick-up into a picture signal was formed in the circuit forming face, The substrate which has the flexibility which supplies the picture signal which was established between said lens installation sections and said semiconductor chips, and was generated with said semiconductor chip to an external circuit, It is characterized by intercepting the light which penetrates this substrate and faces to said semiconductor chip, and having the gobo which eliminates the effect on said photo detector substantially.

[0015] According to invention according to claim 1, the substrate for mounting a semiconductor chip is arranged between the circuit forming face of a semiconductor chip, and the lens for an image pick-up. Thereby, the thickness of a substrate can be arranged in the distance between the lens for an image pick-up, and the photo detector formed in the circuit forming face of a semiconductor device, i.e., the focal distance of the lens for an image pick-up. Therefore, the thickness of the semiconductor device for an image pick-up becomes equal to the sum of the focal distance of the lens for an image pick-up, and the thickness of a semiconductor chip substantially. That is, since the thickness of a substrate is not contained in the thickness of the whole equipment, it can decrease the thickness of the whole equipment. Moreover, although the substrate which has flexibility has the property which penetrates light, by preparing a gobo, it can intercept the light which has passed the substrate, can eliminate the effect on a photo detector substantially, and can prevent degradation of image quality.

[0016] Invention according to claim 2 is a semiconductor device for an image pick-up according to claim 1, said semiconductor chip is mounted in said substrate, after said circuit forming face has turned to said substrate, and it is characterized by said photo detector formed in said circuit forming face having countered with said lens for an image pick-up through opening prepared in said substrate.

[0017] Since opening is formed in the substrate, the lens for an image pick-up in which the photo detector formed in the circuit forming face even if it mounted the semiconductor chip in the substrate by FURIPPUCHIPU mounting etc. was attached through opening in the opposite hand of a substrate can be made to counter according to invention according to claim 2. Moreover, since the tooth back of the opposite hand of the circuit forming face of a semiconductor chip can be supported in case a semiconductor chip is mounted in a substrate, it can mount, carrying out the image recognition of the circuit forming face. Thereby, a semiconductor chip can be mounted in a substrate in a high location precision.

[0018] Invention according to claim 3 is a semiconductor device for an image pick-up according to claim 1 or 2, said lens installation section has the gage pin, said substrate has tooling holes, and said lens installation section is characterized by being fixed to the field of the opposite hand of the field of said substrate with which said semiconductor chip was mounted by adhesives in the condition that said gage pin fitted into said tooling holes.

[0019] According to invention according to claim 3, the lens installation section can be attached in a substrate in a high location precision by fitting the gage pin of the lens installation section into the tooling holes formed in the substrate. Since a semiconductor chip can also be mounted in a high location precision to a substrate, the lens for an image pick-up and a semiconductor chip can be assembled in a high location precision.

[0020] Invention according to claim 4 is a semiconductor device for an image pick-up given in any 1 term claim 1 thru/or among 3, and it is characterized by said gobo having extended toward said semiconductor chip from said lens installation section in opening of said substrate.

[0021] According to invention according to claim 4, a gobo can be formed as a part of lens installation section, and the protection-from-light effectiveness over a photo detector can be acquired easily.

[0022] Invention according to claim 5 is a semiconductor device for an image pick-up according to claim 4, and said gobo is formed with the ingredient which has elasticity, and it is characterized by the head being in contact with said circuit forming face of said semiconductor chip.

[0023] According to invention according to claim 5, when a gobo contacts the circuit forming face of a semiconductor chip, the light which penetrates a substrate can be thoroughly intercepted with a gobo. Moreover, even if a gobo contacts a circuit forming face, in order to carry out elastic deformation of the gobo, it does not do breakage on a circuit forming face.

[0024] Invention according to claim 6 is a semiconductor device for an image pick-up according to claim 2, and said gobo is formed in said lens installation section in one, and it is characterized by fixing the head of said gobo to said circuit forming face of said semiconductor chip by adhesives.

[0025] According to invention according to claim 6, direct ** of the lens installation section can be carried out through a gobo at the circuit forming face of a semiconductor chip. Therefore, while eliminating the effect of the light from the perimeter to a photo detector, the effect of the distance on [between the lenses for an image pick-up and photo detectors by dispersion in the thickness of a substrate] can be eliminated.

[0026] Invention according to claim 7 is a semiconductor device for an image pick-up given in any 1 term claim 1 thru/or among 6, and said lens installation section has the converging section which forms opening which acts as drawing to said lens for an image pick-up, and it is characterized by the edge of said converging section which forms this opening being the inclined plane which carried out predetermined include-angle dip to the optical axis of said lens for an image pick-up.

[0027] According to invention according to claim 7, ** to prevent can perform that the light reflected by the end face of a converging section carries out incidence to a photo detector, and degradation of an image can be prevented.

[0028] Invention according to claim 8 is a semiconductor device for an image pick-up given in any 1 term claim 1 thru/or among 7, and said substrate has the wiring drawer section for connecting with an external circuit, and it is characterized by carrying electronic parts in this wiring drawer section.

[0029] According to invention according to claim 8, by carrying electronic parts in the wiring drawer section, a tooth space can be used effectively and packaging density can be improved.

[0030] The lens installation section in which, as for invention according to claim 9, the lens for an image pick-up was attached, The semiconductor chip with which the photo detector which changes the light from said lens for an image pick-up into a picture signal was formed, It is the semiconductor device for an image pick-up which has the substrate with which said semiconductor chip was mounted. Said lens installation section It has the upper part in which said lens for an image pick-up was attached, and the lower part fixed to said substrate. Said upper part is constituted movable in the direction approached or estranged to said substrate to said lower part, and it is characterized by the distance between said lenses for an image pick-up and said semiconductor chips being adjustable.

[0031] According to invention according to claim 9, when the distance between the lens for an image pick-up and a semiconductor chip changes, it can adjust so that the focus of the lens for an image pick-up may always be in agreement with a photo detector. Thereby, the image whose focus always suited

can be obtained.

[0032] Invention according to claim 10 is a semiconductor device for an image pick-up according to claim 9, and when said upper part moves in the direction estranged from said substrate, it is characterized by having escaped so that said upper part might not separate from said lower part, and establishing a stop device.

[0033] According to invention according to claim 9, when the distance between the lens for an image pick-up and a semiconductor chip changes, it can adjust so that the focus of the lens for an image pick-up may always be in agreement with a photo detector. Thereby, the image whose focus always suited can be obtained.

[0034] According to invention according to claim 10, it can prevent separating in screw connection **** of the upper part by oscillation of equipment by escaping so that the upper part in which the lens was prepared may not separate from a lower part, and establishing a stop device.

[Embodiment of the Invention] Next, the gestalt of operation of this invention is explained with a drawing.

[0035] Drawing 1 (a) is the sectional view of the semiconductor device for an image pick-up by the 1st example of this invention, and drawing 1 (b) is the top view of the light-receiving side of the semiconductor chip shown in drawing 1 (a). The semiconductor device 10 for an image pick-up by the 1st example of this invention consists of the semiconductor chip 12 for a solid-state image pick-up, a TAB tape substrate 14, and the lens installation section 16.

[0036] It turns flip chip mounting of the semiconductor chip 12 up at the TAB tape substrate 14. The lens installation section 16 constitutes the optical system containing a lens (objective lens) 18, and is carried in the opposite hand of a semiconductor chip 12 to the TAB tape substrate 14. That is, a semiconductor chip 12 and the lens installation section 16 are carried in the both sides on both sides of the TAB tape substrate 14.

[0037] The C-MOS sensor is formed in circuit forming face (light-receiving side) 12a of a semiconductor chip 12 as a photo detector for an image pick-up. A semiconductor chip 12 is in the condition which turned circuit forming face 12a to the TAB tape substrate 14, and flip chip mounting is carried out to the TAB tape substrate 14.

[0038] Opening 14a is prepared in the location corresponding to the C-MOS sensor (photo detector) formed in circuit forming face 12a of a semiconductor chip 12 at the TAB tape substrate 14. Therefore, where a semiconductor chip 12 is mounted in the TAB tape substrate 14, the C-MOS sensor of a semiconductor chip 12 will be located in opening 14a of the TAB tape substrate 14.

[0039] As for the TAB tape substrate 14, wiring 14B is formed in polyimide tape 14A. Wiring 14B sticks copper foil on polyimide tape 14A, and is formed by carrying out pattern formation of the copper foil. Bump 12b is formed in the semiconductor chip 12 as a terminal for external connection. Bump 12b is joined to the bonding pad formed as a part of wiring 14B of the TAB tape substrate 14 with anisotropy electric conduction resin 20. In addition, polyimide tape 14A is good also as the ingredient which has suitable flexibility, for example, a polyester tape, without being restricted to this. Moreover, the ingredient which forms wiring 14B is good also as using aluminum foil etc., for example, without being restricted to copper foil.

[0040] Body 16A of the lens installation section 16 has opening penetrated in the center section, and the upper part of this opening is established in the lens 18 in the state of the wrap. A lens 18 is inserted in the upper part of opening of body 16A, and is fixed with the lens presser-foot lid 22. The lens presser-foot lid 22 is fixed to body 16A by adhesives 24.

[0041] The lens installation section 16 is in the condition whose opening of body 16A corresponded with opening 14a of the TAB tape substrate 14, and is fixed by adhesives 26 to the TAB tape substrate 14. The pin 28 for positioning is formed in body 16A, and body 16A of the lens installation section 16 is positioned by accuracy by fitting into tooling-holes 14b by which the pin 28 for positioning was formed in the TAB tape substrate 14.

[0042] Since tooling-holes 14b prepared in the TAB tape substrate 14 is formed of etching etc. on the

basis of the tooling holes for circuit patterns, it is formed in a high location precision to a circuit pattern. Therefore, the lens installation section 16 is attached in a high location precision to the TAB tape substrate 14 by fitting a gage pin 28 into tooling-holes 14b.

[0043] The converging section 30 is formed in the lens 18 bottom of opening of body 16A of the lens installation section 16. Moreover, the IR filter 32 is arranged further at the converging section 30 bottom.

[0044] In the above configurations, the light condensed with the lens 18 passes a converging section 30 and the IR filter 32, and they carry out incidence to the C-MOS sensor formed in circuit forming face 12a of a semiconductor chip 12. The distance between a lens 18 and circuit forming face 12a is set up so that it may become equal to the focal distance of a lens 18. Therefore, on a C-MOS sensor, it is condensed and the light which carried out incidence to the lens 18 carries out image formation.

[0045] And the image on a C-MOS sensor is changed into an electrical signal by the C-MOS sensor, and is supplied to an external device through wiring cash-drawer section 14c of the TAB tape substrate 14 as a picture signal.

[0046] Drawing 2 (a) is the top view of the above-mentioned TAB tape substrate 14. Drawing 2 (b) is drawing showing the example for comparing with the TAB tape substrate 14 shown in drawing 2 (a), and is the top view of the substrate in the case of carrying a semiconductor chip 12 in a substrate by wirebonding.

[0047] In the substrate 40 shown in drawing 2 (b), the pad 42 for wirebonding is formed in the perimeter of a semiconductor chip 12, and the electrode of a semiconductor chip 12 is electrically connected to a pad by the bonding wire 44. Therefore, the field in which a pad 42 is formed is required for the perimeter of a semiconductor chip 12.

[0048] On the other hand, in the TAB tape substrate 14 shown in drawing 2 (a), since flip chip mounting of the semiconductor chip 12 is carried out, the pad of the TAB tape substrate 14 serves as a location which laps with the electrode of a semiconductor chip 12. Thus, the field in which a pad is prepared does not need to serve as the inside of a semiconductor chip 12, and it is not necessary to establish the field in which a pad is prepared like the example shown in drawing 2 (b) in the perimeter of a semiconductor chip 12. Therefore, area (dimension) of the TAB tape substrate 14 by this example shown in drawing 2 (a) can be made smaller than the substrate of the example shown in drawing 2 (b), and can also make small the overall dimension of the semiconductor device 10 for an image pick-up.

[0049] Drawing 3 is drawing showing the example which connected to the external circuit the semiconductor device 10 for an image pick-up shown in drawing 1 (a). The semiconductor device 10 for an image pick-up is connected to the printed circuit board 50 prepared in the portable telephone when included in a portable telephone. Specifically, wiring drawer section 14c of the TAB tape substrate 14 of the semiconductor device 10 for an image pick-up is connected to the wiring 52 of a printed circuit board 50 by the pewter 54.

[0050] Here, since the TAB tape substrate 14 is formed with the ingredient which has the flexibility of polyimide etc., it can bend the TAB tape substrate 14 freely after solder connection. In the example shown in drawing 3, the TAB tape substrate 14 was crooked and the semiconductor device 10 for an image pick-up is arranged above a printed circuit board 50. Thus, a degree of freedom can be given to the case design of the device (here portable telephone) by which the semiconductor device 10 for an image pick-up is incorporated by using the TAB tape substrate 14 which has flexibility.

[0051] When the substrate which does not have flexibility instead of the TAB tape substrate 14 is used, the degree of freedom of the location of the semiconductor device 10 for an image pick-up increases by forming a flexible substrate between printed circuit boards 50, and connecting with the semiconductor device 10 for an image pick-up. However, area only with the excessive part which attaches a flexible substrate will be needed, and a production process will also be complicated.

[0052] Drawing 4 is the enlarged drawing of the A section in drawing 1 (a). The gobo 60 is formed in the base of the body of the lens installation section 16. A gobo 60 is formed so that the lens installation section 16 may cover the inner surface of opening 14a of the TAB tape substrate 14 over having been

carried in the TAB tape substrate 14 to the perimeter (refer to drawing 1 (b)).

[0053] Drawing 5 is drawing for explaining an operation of a gobo 60, drawing 5 (a) shows the condition of having not formed the gobo 60, and drawing 5 (b) shows the condition of having formed the gobo 60.

[0054] When the gobo 60 is not formed, as shown in drawing 5 (a), the light (an arrow head shows among drawing) which penetrated polyimide tape 14A of the TAB tape substrate 14 will carry out incidence into opening 14a. That is, since these tapes will tend [comparatively] to penetrate light if resin tapes, such as a polyimide tape or a polyethylene tape, are used in order to consider as the substrate which has flexibility, light keeps close in opening 14a of the TAB tape substrate 14. Incidence of a part of light which entered in opening 14a is carried out to light sensing portion 12c (C-MOS sensor) of a semiconductor chip 12, it generates halation, and degrades an image.

[0055] However, in this example, since the inner surface of opening 14a is covered with the gobo 60 as shown in drawing 1 (b) and drawing 5 R> 5 (b), the light (an arrow head shows among drawing) which has penetrated polyimide tape 14A is interrupted with a gobo 60, and does not reach light sensing portion 12c of a semiconductor chip 12. Therefore, by forming a gobo 60, generating of the halation resulting from the light which penetrates the TAB tape substrate 14 can be prevented, and degradation of an image can be prevented.

[0056] In addition, although few gaps are formed between a gobo 60 and the circuit forming face (light-receiving side) of a semiconductor chip and light may leak from that gap, the amounts of this leaking light are few in an emergency, and do not do effect substantially to a light-receiving side.

[0057] Drawing 6 is the sectional view showing the modification of a gobo 60. The gobo 62 shown in drawing 6 is created with the ingredient which has elasticity, and is attached in body 16A of the lens installation section 16. The mounting arrangement forms in body 16A the fitting section which receives some gobos 62, is good also as inserting in a gobo 62 and fixing, and may fix it with adhesives etc.

[0058] The gobo 62 enlarges slightly the dimension which projects from the base of body 16A from the distance from the base of body 16A to circuit forming face 12a of a semiconductor chip 12. Thereby, where the lens installation section 16 and a semiconductor chip 12 are carried in the TAB tape substrate 14, a gobo 62 contacts circuit forming face 12a of a semiconductor chip 12, and a gap is not formed between a gobo 62 and circuit forming face 12a. Therefore, the light which penetrated the TAB tape 14 is thoroughly intercepted with a gobo 62, and does not arrive at the light-receiving side in opening 14a. In addition, since a gobo 62 is formed with the ingredient which has elasticity, even if a gobo 62 contacts circuit forming face 12a, elastic deformation is carried out and breakage is not done to circuit forming face 12a.

[0059] Drawing 7 is the sectional view showing the modification of the installation structure of the lens installation section 16 including a gobo. In the modification shown in drawing 7, the gobo 64 has the comparatively big thickness as a part of body 16A of the lens installation section 16. and body 16A -- a gobo 64 -- minding -- a conductor -- it is fixed to circuit forming face 12a of a chip by adhesives 66. That is, the lens installation section 16 is fixed to a semiconductor chip 12 rather than is carried in the TAB tape substrate 14.

[0060] According to installation structure as shown in drawing 7, the lens installation section 16 which constitutes optical system is separable from the TAB tape substrate 14. It can prevent that the external force which acts on the lens installation section 16 carries out a direct action to the TAB tape substrate 14 by this.

[0061] For example, when the semiconductor device 10 for an image pick-up by this example is built into a portable telephone, the lens installation section 16 is attached in the case of a portable telephone. In the case of this installation, when external force acts on the lens installation section 16 and it acts on the part which requires this external force for an electrical signal like the TAB tape substrate 14, a defect may occur into an electric part and dependability may fall.

[0062] However, in the example shown in drawing 7, since body 16A of the lens installation section 16 does not touch the TAB tape substrate 14, the problem resulting from the external force which acts on

the above lens installation sections 16 is not produced. Moreover, since the gobo 64 formed in body 16A in one is fixed to circuit forming face 12a of a semiconductor chip 12 by adhesives 66, the light which has penetrated the TAB tape substrate 14 can also be intercepted thoroughly.

[0063] Drawing 8 is the enlarged drawing of the B section of drawing 1. As shown in drawing 8, inclined plane 30a toward which only the predetermined include angle theta inclined to the optical axis of a lens is prepared in a part for the point of the converging section 30 in this example. Although drawing 9 is drawing showing the path of light in case inclined plane 30a is not prepared, it is reflected by the end face, and incidence of the light which penetrated the lens 18 in this case and reached the end face of a converging section 30 is carried out to a light-receiving side, and it causes degradation of an image. So, by preparing predetermined inclined plane 30a of which include-angle theta dip was done to the optical axis of a lens, it consists of this examples so that the light which has penetrated the lens may reflect by the end face of a converging section 30 and may not arrive at a light-receiving side.

[0064] Next, it explains, referring to drawing 10 about the 2nd example of this invention. Drawing 10 is the sectional view of the semiconductor device 70 for an image pick-up by the 2nd example of this invention. In addition, in drawing 10 $R > 0$, the same reference mark is given to components equivalent to the component part shown in drawing 1, and the explanation is omitted.

[0065] In the semiconductor device for an image pick-up by the 2nd example of this invention, opening by which a semiconductor chip 12 goes into polyimide tape 14A of the TAB tape substrate 14 is formed beforehand. Moreover, tinning is performed to wiring 14B which carried out pattern formation of the copper foil etc. by etching. And bump 12b of a semiconductor chip 12 is formed as a golden bump, and golden bump 12b and wiring 14B are joined by ILB connection (gold tin eutectic connection). After connecting golden bump 12b and wiring 14B, potting of the restoration resin 72 is carried out near the joint of golden bump 12b, and it is filled up with it. And the lens installation section 16 is arranged on restoration resin 72, and it fixes with adhesives 26.

[0066] According to this example, the TAB tape substrate 14 is used with the reverse sense with the 1st above-mentioned example, and polyimide tape 14A of the TAB tape substrate 14 does not intervene between the lens installation section 16 and a semiconductor chip 12. Therefore, even if dispersion is in the thickness of polyimide tape 14A, the distance between a lens 18 and a semiconductor chip 12 is kept constant. Moreover, it is not necessary to prepare the protection-from-light section for shading the light which penetrates polyimide tape 14A.

[0067] Next, it explains, referring to drawing 11 about the 3rd example of this invention. Drawing 11 is the sectional view of the semiconductor device 80 for an image pick-up by the 3rd example of this invention. In addition, in drawing 11 $R > 1$, the same reference mark is given to components equivalent to the component part shown in drawing 1, and the explanation is omitted.

[0068] In the semiconductor device for an image pick-up by the 3rd example of this invention, opening by which a semiconductor chip 12 goes into polyimide tape 14A of the TAB tape substrate 14 is formed beforehand. Moreover, it gold-plates to wiring 14B which carried out pattern formation of the copper foil etc. by etching. And wiring 14B and bump 12b of a semiconductor chip 12 to which gold plate was performed are connected by single point bonding. After connecting bump 12b and wiring 14B, potting of the restoration resin 72 is carried out near the joint of golden bump 12b, and it is filled up with it. And the lens installation section 16 of a configuration as shown in drawing 7 is arranged on circuit forming face 12a of a semiconductor chip 12, and it fixes with adhesives 66.

[0069] According to this example, the TAB tape substrate 14 is used with the reverse sense with the 1st above-mentioned example, and polyimide tape 14A of the TAB tape substrate 14 does not intervene between the lens installation section 16 and a semiconductor chip 12. Therefore, even if dispersion is in the thickness of polyimide tape 14A, the distance between a lens 18 and a semiconductor chip 12 is kept constant. Moreover, it can prevent that a gap is not formed between the lens installation section 16 and a semiconductor chip 12, and an unnecessary light carries out incidence of the lens installation section 16 to the light-receiving side of a semiconductor chip 12 since circuit forming face 12a of a

semiconductor chip 12 is pasted directly.

[0070] Next, it explains, referring to drawing 12 about the 4th example of this invention. Drawing 12 is the sectional view of the semiconductor device 90 for an image pick-up by the 4th example of this invention. In addition, in drawing 12 R> 2, the same reference mark is given to components equivalent to the component part shown in drawing 1, and the explanation is omitted.

[0071] Although the semiconductor device 90 for an image pick-up shown in drawing 12 has the same configuration as the semiconductor device 10 for an image pick-up fundamentally shown in drawing 1, it differs that body 16A of the lens installation section 16 is divided into upper part 16A-1 and lower part 16A-2. Moreover, in this example, the mounting components 92 were carried and soldered to wiring drawer section 14c of the TAB tape substrate 14, wiring drawer section 14c was used effectively, and mounting of high density is realized.

[0072] A lens 18 is attached in upper part 16A-1, and a converging section 30, the IR filter 32, and a gobo 60 are formed in lower part 16A-2. And screw connection is made mutually and upper part 16A-1 and lower part 16A-2 can separate upper part 16A-1 from lower part 16A-2. That is, it has the composition that the lens 18 in optical system can be removed from the semiconductor device 90 for an image pick-up.

[0073] In case the mounting components 92 are soldered to the TAB tape substrate 14, it carries by the solder reflow, but since a lens 18 is a plastic lens, it has a possibility that a plastic lens may receive breakage with the heat at the time of a solder reflow. So, in this example, upper part 16A-1 containing a lens 18 can be removed from the semiconductor device 90 for an image pick-up at the time of a solder reflow. After a solder reflow is completed, by making screw connection of upper part 16A-1 lower part 16A-2, a lens 18 is easily incorporable.

[0074] Moreover, although it is unnecessary with this example and an above-mentioned example, a lens 18, circuit forming face (light-receiving side) 12a of a semiconductor chip 12, and distance of a between can also be made adjustable. That is, by rotating upper part 16A-1 to lower part 16A-2, it can move in the vertical direction and the location of a lens 18 can change the distance between a lens 18 and circuit forming face 12a.

[0075] Drawing 13 is the sectional view expanding and showing a part for the screw connection of upper part 16A-1 and lower part 16A-2. A thread part loosens by oscillation etc., it rotates, and screw connection has a possibility that the distance between a lens 18 and a semiconductor chip 12 may change, or upper part 16A-1 may separate.

[0076] So, at this example, above-mentioned nonconformity is coped with by giving the omission stop and baffle of upper part 16A-2. First, it explains, escaping and referring to drawing 14 thru/or 17 about a stop.

[0077] Drawing 14 is the perspective view for a screw connection of lower part 16A-2. The height 92 of a couple is formed in the part which countered the point for a screw connection on the diameter direction. Each height 92 is formed between the slitting slots 94 on the couple (slit) established in the lengthwise direction. When external force acts in the diameter direction, let the part between the slitting slots 94 be the width of face of extent which can carry out elastic deformation easily.

[0078] Drawing 15 is the expanded sectional view of a part in which the height 92 was formed. Thickness radial [the] is also made small and elastic deformation is easily [radially] possible for the part in which a height 92 is formed. The height 92 projects on the radial top outside rather than the screw connection. Suitable dip is established in the upper bed side of a height 92, and in case the screw connection of upper part 16A-1 is thrust into a part for the screw connection of lower part 16A-2, elastic deformation can be easily carried out to the radial inside. That is, by pressing the screw connection of upper part 16A-1 to the upper bed side of a height 92, elastic deformation of the height 92 can be carried out to the radial inside, and it can protest to the screw connection of lower part 16A-2 against the screw connection of upper part 16A-1 easily.

[0079] If it protests to the screw connection of lower part 16A-2 against the screw connection of upper

part 16A-1, the height 92 which was carrying out elastic deformation will return to the original location. Although carried out, when it moves in ** and the direction which upper part 16A-1 removes, the screw connection contacts the soffit side of a height 92. When this moves in the direction from which the upper part rotates by oscillation and it separates, migration beyond it is prevented by the soffit side of a height 92. Therefore, upper part 16A-1 escapes from the soffit side of a height 92, and it acts as a stop. [0080] However, by turning in the direction which removes upper part 16A-1 compulsorily, elastic deformation of the height 92 is carried out to the radial inside and it permits migration of the screw connection of upper part 16A-1 to remove upside edge 16A-1. That is, when a height 92 falls out and acts as a stop, when a small turning effort by oscillation etc. acts on upper part 16A-1, and a big turning effort acts, migration of the upper part is permitted.

[0081] Drawing 16 is the sectional view showing other examples of a height 92. As for height 92A shown in drawing 16 (a), the upper bed side and soffit side are roundish, and the screw connection of upper part 16A-1 can slide on a height 92A top smoothly.

[0082] Moreover, although, as for the upper bed side, height 92B shown in drawing 16 (b) is roundish, the soffit side is incised at the right angle. According to the configuration of height 92B, the screw connection of upper part 16A-1 can thrust into a part for the screw connection of a lower part easily, but once it is thrust, migration of a connection is prevented by the soffit side of height 92B even if a big turning effort acts on upper part 16A-1.

[0083] Drawing 17 is the sectional view showing other examples of the omission stop of the upper part. In the example shown in drawing 17, the slot 96 was established in the periphery of the point of the screw connection of lower part 16A-2, it escaped in the slot 96, and the ring 98 for stops is arranged. As shown in drawing 17 (b), a ring 98 is the circle configuration from which the part was removed, and is formed with the metal wire or resin which has elasticity.

[0084] The ring 98 is formed in a round shape which comes out outside from the abbreviation one half fang furrow 96 of a cross section as shown in drawing 17 (a). In case the ring 98 is beforehand inserted in the slot 96 and the screw connection of upper part 16A-1 is thrust, it is compressed inside and the path becomes small. That is, a ring 98 will be in the condition of having held in the slot 96 and having hung down, and the screw connection of upper part 16A-1 can pass the part of a ring 98 easily.

[0085] If the screw connection of upper part 16A-1 passes the part of a ring 98, a ring 98 will be in the condition which shows in the original configuration at return and drawing 17 (a). Therefore, even if it moves in the direction from which upper part 16A-1 separates, a ring 98 cannot fall out, it cannot act as a stop, and upper part 16A-1 cannot be moved over a ring 98.

[0086] In addition, after forming a ring 98 with a shape memory alloy and thrusting the upper part, it is good also as heating a ring 98 and returning to the original configuration. That is, it is made to memorize as a condition which shows the configuration of a ring 98 in drawing 17 (a), and the path is made small when inserting in a slot 96. That is, it is made for the whole to enter a slot 96 as a path with a ring 98 small at first. And after upper part 16A-1 is thrust, a ring 98 is heated and it returns to the original configuration. That is, after upper part 16A-1 is thrust, by considering as the condition which a ring 98 is heated and shows in drawing 17 (a), it escapes from a ring 98 and it acts as a stop.

[0087] Drawing 18 is the sectional view showing the example which prepared the baffle between the upper part and a lower part. In the example shown in drawing 18, the slot 100 was established in the screw connection of upper part 16A-1, and O ring 102 of spring materials, such as rubber, is formed in the slot 100. The configuration of a slot 100 and the configuration of an O ring are set up so that O ring 102 may contact the peripheral face of the upper bed section of the screw connection of lower part 16A-2. Thereby, when the screw connection of upper part 16A-1 is thrust to some extent, O ring 102 contacts the screw connection of lower part 16A-2. Then, O ring 102 thrusts upper part 16A-1 further, where elastic deformation is carried out. thereby, between the screw connection of upper part 16A-1, and lower part 16A-2, O ring 102 is formed, where elastic deformation is carried out --- ***** --- friction of O ring 102 --- upper part 16A-1 --- it will be in the condition of not turning easily. It can

prevent that upper part 16A-1 rotates by oscillation etc., and the distance between a lens 18 and a light-receiving side changes by this.

[Effect of the Invention] According to this invention, the various effectiveness described below is realizable like ***. According to invention according to claim 1, the substrate for mounting a semiconductor chip is arranged between the circuit forming face of a semiconductor chip, and the lens for an image pick-up. Thereby, the thickness of a substrate can be arranged in the distance between the lens for an image pick-up, and the photo detector formed in the circuit forming face of a semiconductor device, i.e., the focal distance of the lens for an image pick-up. Therefore, the thickness of the semiconductor device for an image pick-up becomes equal to the sum of the focal distance of the lens for an image pick-up, and the thickness of a semiconductor chip substantially. That is, since the thickness of a substrate is not contained in the thickness of the whole equipment, it can decrease the thickness of the whole equipment. Moreover, although the substrate which has flexibility has the property which penetrates light, by preparing a gobo, it can intercept the light which has passed the substrate, can eliminate the effect on a photo detector substantially, and can prevent degradation of image quality.

[0088] Since opening is formed in the substrate, the lens for an image pick-up in which the photo detector formed in the circuit forming face even if it mounted the semiconductor chip in the substrate by FURIPPUCHIPU mounting etc. was attached through opening in the opposite hand of a substrate can be made to counter according to invention according to claim 2. Moreover, since the tooth back of the opposite hand of the circuit forming face of a semiconductor chip can be supported in case a semiconductor chip is mounted in a substrate, it can mount, carrying out the image recognition of the circuit forming face. Thereby, a semiconductor chip can be mounted in a substrate in a high location precision.

[0089] According to invention according to claim 3, the lens installation section can be attached in a substrate in a high location precision by fitting the gage pin of the lens installation section into the tooling holes formed in the substrate. Since a semiconductor chip can also be mounted in a high location precision to a substrate, the lens for an image pick-up and a semiconductor chip can be assembled in a high location precision.

[0090] According to invention according to claim 4, a gobo can be formed as a part of lens installation section, and the protection-from-light effectiveness over a photo detector can be acquired easily.

[0091] According to invention according to claim 5, when a gobo contacts the circuit forming face of a semiconductor chip, the light which penetrates a substrate can be thoroughly intercepted with a gobo. Moreover, even if a gobo contacts a circuit forming face, in order to carry out elastic deformation of the gobo, it does not do breakage on a circuit forming face.

[0092] According to invention according to claim 6, direct ** of the lens installation section can be carried out through a gobo at the circuit forming face of a semiconductor chip. Therefore, while eliminating the effect of the light from the perimeter to a photo detector, the effect of the distance on [between the lenses for an image pick-up and photo detectors by dispersion in the thickness of a substrate] can be eliminated.

[0093] According to invention according to claim 7, ** to prevent can perform that the light reflected by the end face of a converging section carries out incidence to a photo detector, and degradation of an image can be prevented.

[0094] According to invention according to claim 8, by carrying electronic parts in the wiring drawer section, a tooth space can be used effectively and packaging density can be improved.

[0095] According to invention according to claim 9, when the distance between the lens for an image pick-up and a semiconductor chip changes, it can adjust so that the focus of the lens for an image pick-up may always be in agreement with a photo detector. Thereby, the image whose focus always suited can be obtained.

[0096] According to invention according to claim 10, it can prevent separating in screw connection ***

of the upper part by oscillation of equipment by escaping so that the upper part in which the lens was prepared may not separate from a lower part, and establishing a stop device.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] (a) is the sectional view of the semiconductor device for an image pick-up by the 1st example of this invention, and (b) is the top view of the light-receiving side of a semiconductor chip.

[Drawing 2] (a) is the top view of the TAB tape substrate shown in drawing 1, and (b) is the top view of the printed circuit board in the case of carrying out wirebonding of the semiconductor chip.

[Drawing 3] It is drawing showing the configuration for building into a device the semiconductor device for an image pick-up shown in drawing 1 (a).

[Drawing 4] It is the enlarged drawing of the A section of drawing 1 (a).

[Drawing 5] It is a sectional view for explaining an operation of the gobo shown in drawing 1.

[Drawing 6] It is the sectional view showing the modification of a gobo.

[Drawing 7] It is the sectional view showing the example which connects the body and semiconductor chip of the lens installation section through a gobo.

[Drawing 8] It is the enlarged drawing of the B section shown in drawing 1.

[Drawing 9] It is drawing for explaining the optical path of light reflected by the converging section.

[Drawing 10] It is the sectional view of the semiconductor device for an image pick-up by the 2nd example of this invention.

[Drawing 11] It is the sectional view of the semiconductor device for an image pick-up by the 3rd example of this invention.

[Drawing 12] It is the sectional view of the semiconductor device for an image pick-up by the 4th example of this invention.

[Drawing 13] It is an expanded sectional view near [which is shown in drawing 12] a screw connection.

[Drawing 14] It is the perspective view of the height prepared for the screw connection of the lower part shown in drawing 12.

[Drawing 15] It is the sectional view of the height shown in drawing 14.

[Drawing 16] It is the sectional view showing the modification of the height shown in drawing 15.

[Drawing 17] It is the sectional view showing other examples of an omission stop prepared for a screw connection.

[Drawing 18] It is the sectional view showing the baffle prepared for a screw connection.

[Description of Notations]

10, 70, 80, 90 Semiconductor device for an image pick-up

12 Semiconductor Chip

12a Circuit forming face
12b Bump
12c Light sensing portion
14 TAB Tape Substrate
14A Polyimide tape
14B, 52 Wiring
14a Opening
14b Tooling holes
14c Wiring drawer section
16 Lens Installation Section
16A Body
16A-1 Upper part
16A-2 Lower part
20 Anisotropy Electric Conduction Resin
22 Lens Presser-Foot Lid
24 26 Adhesives
30 Converging Section
32 IR Filter
50 Printed Circuit Board
54 Solder
60, 62, 64 Gobo

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2002-135632
(P2002-135632A)

(43)公開日 平成14年5月10日(2002.5.10)

(51) Int.Cl.⁷ 識別記号
H 0 4 N 5/225
H 0 1 L 21/60 3 1 1
27/14
H 0 4 N 5/335

F I		テマコード(参考)
H 0 4 N	5/225	D 4 M 1 1 8
H 0 1 L	21/60	3 1 1 S 5 C 0 2 2
		3 1 1 R 5 C 0 2 4
H 0 4 N	5/335	V 5 F 0 4 4
H 0 1 L	27/14	D

(21)出願番号 特願2000-320001(P2000-320001)

(71) 出願人 000005223
富士通株式会社
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号
(72) 発明者 誉田 敏幸
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内
(72) 発明者 貴田 進
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内
(74) 代理人 100070150
弁理士 伊東 忠彦

(22)出願日 平成12年10月19日(2000. 10. 19)

(22)出願日 平成12年10月19日(2000.10.19) (3)住所 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

(22)出願日 平成12年10月19日 (2000. 10. 19) (72)発明者 神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番
1 号 誉田 敏幸 神奈川県川崎市中原区上小田中 4 丁目 1 番
1 号 富士通株式会社内

(72)発明者 貴田 進
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

(74) 代理人 100070150
弁理士 伊東 康彦

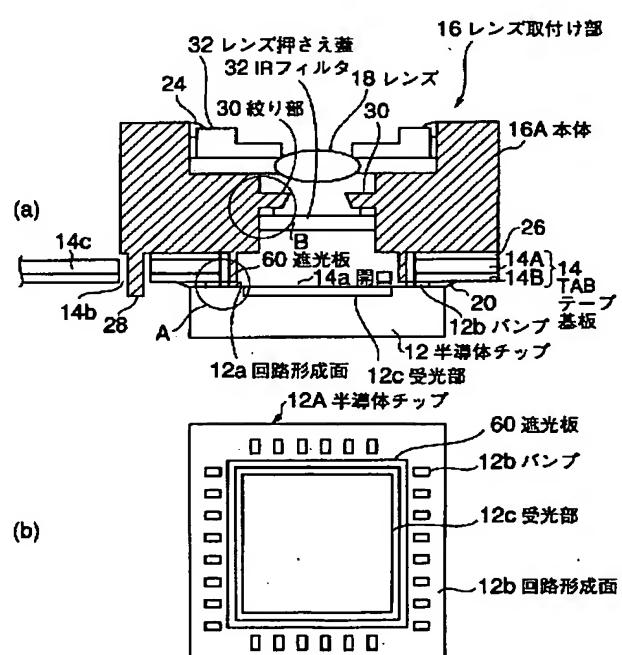
(54) 【発明の名称】 撮像用半導体装置

(57) 【要約】

【課題】 本発明は受光素子を有する半導体素子と撮像用レンズとをパッケージした撮像用半導体装置に関し、従来装置より厚みが小さく面積も小さい撮像用半導体装置を提供することを課題とする。

【解決手段】 撮像用レンズ18が取り付けられたレンズ取り付け部16がTABテープ基板14に取り付けられる。レンズ取り付け部16の反対側に撮像用半導体チップ12を実装する。レンズ18と半導体チップ12の受光素子とはTABテープ基板14に形成された開口14aを介して互いに対向する。TABテープ基板14を透過して半導体チップ12に向かう光を遮光板60により遮断して、受光素子への影響を実質的に排除する。

本発明の第1実施例による撮像用半導体装置の断面図



(2)

2

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 撮像用レンズが取り付けられたレンズ取り付け部と、前記撮像用レンズからの光を画像信号に変換する受光素子が回路形成面に形成された半導体チップと、前記レンズ取り付け部と前記半導体チップとの間に設けられ、前記半導体チップにより生成された画像信号を外部回路に供給する柔軟性を有する基板と、該基板を透過して前記半導体チップに向かう光を遮断して、前記受光素子への影響を実質的に除去する遮光板とを有することを特徴とする撮像用半導体装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の撮像用半導体装置であつて、前記半導体チップは前記回路形成面が前記基板に向いた状態で前記基板に実装され、前記回路形成面に形成された前記受光素子は前記基板に設けられた開口を介して前記撮像用レンズと対向していることを特徴とする撮像用素子。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 記載の撮像用半導体装置であつて、

前記レンズ取り付け部は位置決めピンを有しており、前記基板は位置決め孔を有しており、前記位置決めピンが前記位置決め孔に嵌合した状態において、前記レンズ取り付け部は前記半導体チップが実装された前記基板の面の反対側の面に接着剤により固定されていることを特徴とする撮像用半導体装置。

【請求項 4】 請求項 1 乃至 3 のうちいずれか一項記載の撮像用半導体装置であつて、

前記遮光板は前記基板の開口内において前記レンズ取り付け部から前記半導体チップに向かって延在していることを特徴とする撮像用半導体装置。

【請求項 5】 請求項 4 記載の撮像用半導体装置であつて、

前記遮光板は弾性を有する材料で形成されており、先端が前記半導体チップの前記回路形成面に当接していることを特徴とする撮像用半導体装置。

【請求項 6】 請求項 2 記載の撮像用半導体装置であつて、

前記遮光板は前記レンズ取り付け部に一体的に形成されており、前記遮光板の先端は前記半導体チップの前記回路形成面に接着剤により固定されていることを特徴とする撮像用半導体装置。

【請求項 7】 請求項 1 乃至 6 のうちいずれか一項記載の撮像用半導体装置であつて、

前記レンズ取り付け部は前記撮像用レンズに対する絞りとして作用する開口を形成する絞り部を有しており、該開口を形成する前記絞り部の端部は前記撮像用レンズの光軸に対して所定角度傾斜した傾斜面であることを特徴とする撮像用半導体装置。

【請求項 8】 請求項 1 乃至 7 のうちいずれか一項記載

の撮像用半導体装置であつて、

前記基板は外部回路に接続されるための配線引き出し部を有しており、該配線引き出し部に電子部品が搭載されていることを特徴とする撮像用半導体装置。

【請求項 9】 撮像用レンズが取り付けられたレンズ取り付け部と、前記撮像用レンズからの光を画像信号に変換する受光素子が形成された半導体チップと、前記半導体チップが実装された基板とを有する撮像用半導体装置であつて、

10 前記レンズ取り付け部は、前記撮像用レンズが取り付けられた上側部分と、前記基板に固定された下側部分とを有し、前記上側部分は前記下側部分に対して前記基板に接近又は離間する方向に移動可能に構成されており、前記撮像用レンズと前記半導体チップとの間の距離は可変であることを特徴とする撮像用半導体装置。

【請求項 10】 請求項 9 記載の撮像用半導体装置であつて、

前記上側部分が前記基板から離間する方向に移動した際に、前記上側部分が前記下側部分から外れないように抜け止め機構が設けられたことを特徴とする撮像用半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は撮像用半導体装置に係わり、特に、受光素子を有する半導体素子と撮像用レンズとをパッケージした撮像用半導体装置に関する。

【0002】近年、小型カメラが組み込まれた携帯電話機やハンディパソコン(携帯型パーソナルコンピュータ)が開発されている。例えば、小型カメラを備えた携帯電話機は、通話者の映像を小型カメラにより撮像して画像データとして取り込み、通話相手にその画像データを送信する。このような小型カメラは、一般的にC-MOSセンサとレンズとにより構成される。

【0003】携帯電話機やハンディパソコンはより一層の小型化が進められており、これらに使用される小型カメラにも小型化が要求されている。このようなカメラへの小型化の要求を満足するために、レンズとC-MOSセンサとを一体化して形成した半導体装置パッケージが開発されている。

【0004】

【従来の技術】特願平11-17997号公報は、撮像用レンズとC-MOSセンサを有する半導体チップとを一体化した構成の半導体装置パッケージを開示している。この半導体装置パッケージにおいて、C-MOSセンサを有する半導体チップは、その受光面が上に向いた状態で、剛性を有するプリント基板の上に搭載され、プリント基板にワイヤボンディングされている。撮像用レンズは、半導体チップの受光面の上方の所定の位置に配置されるよう、プリント基板に対して固定されている。

したがって、特願平11-17997号公報に開示され

(3)

3

た従来の小型カメラ用の半導体装置パッケージは、基板の上に半導体チップが搭載され、その上にレンズが配置されるという構成である。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】上述の構成の半導体装置パッケージは、その構造に起因して以下のような問題を有している。

【0006】1) 受光素子を有する半導体チップの製造過程において、半導体チップの厚みを小さくするために、半導体チップの背面を研磨機で削っている。このため、半導体チップの厚みはウェハ毎に変動する。変動の範囲は通常±1.5 μm程度であるが、許容範囲としては±3.0 μm程度ある。半導体チップの厚みが変動すると、半導体チップの受光面とレンズとの間の距離が変動してしまう。すなわち、レンズはプリント基板の表面から所定の距離に配置され、且つ半導体チップの受光面はプリント基板の表面から半導体チップの厚み分だけ離れた位置に配置されるので、半導体チップの厚みが増大すると受光面はレンズに接近し、半導体チップの厚みが減少すると受光面はレンズから遠ざかる。

【0007】レンズと半導体チップの受光面との間の距離は、レンズの焦点距離に等しく設定されており、レンズによる像が受光面で正確に結像するようになっている。したがって、上述のようにレンズと受光面との間の距離が変動すると、焦点ずれが発生し、画像がボケるといった問題が発生する。

【0008】2) 半導体チップをプリント基板に搭載する際、ダイス付け装置を使用して半導体チップをプリント基板の表面に接着し固定する。ダイス付け装置では、チップの表面（受光素子が形成された面）を吸着して保持し、プリント基板上に搬送して載置する。このため、半導体チップの表面は吸着装置で覆われてしまい、受光素子の形成された面を画像認識することができない。したがって、半導体チップの外形を画像認識し、この外形をプリント基板上で半導体チップを位置決めするための基準としている。しかし、半導体チップの受光面と外形とは必ずしも一定の位置関係とはなっていない。すなわち、半導体チップはウェハをダイシングして分割することにより個片化される。その際に半導体チップの外形が形成されるが、ダイシングによる切断位置が変動することにより、半導体チップの外形に対する受光面の位置は一定とはならない。したがって、レンズの焦点位置が正確に受光面の中心に一致しない場合がある。

【0009】3) 半導体チップはワイヤボンディングによりプリント基板に搭載されるため、ワイヤボンディング用のパッドを半導体チップの周囲に配置しなければならない。したがって、ボンディングパッドを配置する部分をプリント基板に設ける必要があり、半導体装置パッケージの小型化の妨げとなっている。

【0010】4) 半導体装置パッケージとして実質的に

4

必要な厚さは、レンズの焦点距離に半導体チップの厚みを加えた距離である。しかし、上述の従来の半導体装置パッケージでは、半導体チップのレンズの反対側にプリント基板が配置されているため、半導体装置パッケージの実際の厚みは、レンズの焦点距離に半導体チップの厚みを加えた距離に更にプリント基板の厚みを加えた距離となる。したがって、プリント基板の厚み分だけ半導体装置パッケージの厚みが増大している。

【0011】5) プリント基板はセラミックス又はガラス・エポキシ等の剛性を有する材料で形成されている。したがって、プリント基板は屈曲することができず、半導体装置パッケージを機器に組み込む際に配置の自由度が小さいという問題がある。すなわち、小型カメラを形成する半導体装置パッケージを、携帯電話機やハンディパソコン内の主基板に電気的に接続するには、パッケージを直接主基板に実装するか、あるいは主基板と半導体装置パッケージとの間にフレキシブル配線基板を設ける必要があるといった制約がある。このような制約は携帯電話機やハンディパソコンの筐体設計の自由度を低くする。

【0012】本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、従来装置より厚みが小さく、面積も小さいパッケージされた撮像用半導体装置を提供することを主な目的とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するために本発明では、次に述べる各手段を講じたことを特徴とするものである。

【0014】請求項1記載の発明は、撮像用半導体装置であって、撮像用レンズが取り付けられたレンズ取り付け部と、前記撮像用レンズからの光を画像信号に変換する受光素子が回路形成面に形成された半導体チップと、前記レンズ取り付け部と前記半導体チップとの間に設けられ、前記半導体チップにより生成された画像信号を外部回路に供給する柔軟性を有する基板と、該基板を透過して前記半導体チップに向かう光を遮断して、前記受光素子への影響を実質的に排除する遮光板とを有することを特徴とするものである。

【0015】請求項1記載の発明によれば、半導体チップを実装するための基板は半導体チップの回路形成面と撮像用レンズとの間に配置される。これにより、基板の厚みを撮像用レンズと半導体装置の回路形成面に形成された受光素子との間の距離、すなわち撮像用レンズの焦点距離内に配置することができる。したがって、撮像用半導体装置の厚みは、実質的に撮像用レンズの焦点距離と半導体チップの厚みとの和に等しくなる。すなわち、基板の厚さは装置全体の厚みに含まれないため装置全体の厚みを減少することができる。また、柔軟性を有する基板は光を透過する特性を有しているが、遮光板を設けることにより基板を通過してきた光を遮断して受光素子

(4)

5

への影響を実質的に排除することができ、画質の劣化を防止することができる。

【0016】請求項2記載の発明は、請求項1記載の撮像用半導体装置であって、前記半導体チップは前記回路形成面が前記基板に向いた状態で前記基板に実装され、前記回路形成面に形成された前記受光素子は前記基板に設けられた開口を介して前記撮像用レンズと対向していることを特徴とするものである。

【0017】請求項2記載の発明によれば、基板に開口が形成されているため、フリップチップ実装等により半導体チップを基板に実装しても回路形成面に形成された受光素子を、開口を介して基板の反対側に取り付けられた撮像用レンズに対向させることができる。また、半導体チップを基板に実装する際に、半導体チップの回路形成面の反対側の背面を支持することができるため、回路形成面を画像認識しながら実装を行うことができる。これにより、半導体チップを高い位置精度で基板に実装することができる。

【0018】請求項3記載の発明は、請求項1又は2記載の撮像用半導体装置であって、前記レンズ取り付け部は位置決めピンを有しており、前記基板は位置決め孔を有しており、前記位置決めピンが前記位置決め孔に嵌合した状態において、前記レンズ取り付け部は前記半導体チップが実装された前記基板の面の反対側の面に接着剤により固定されていることを特徴とするものである。

【0019】請求項3記載の発明によれば、基板に形成された位置決め孔にレンズ取り付け部の位置決めピンを嵌合することにより、レンズ取り付け部を高い位置精度で基板に取り付けることができる。半導体チップも基板に対して高い位置精度で実装することができるため、撮像用レンズと半導体チップとを高い位置精度で組み立てることができる。

【0020】請求項4記載の発明は、請求項1乃至3のうちいずれか一項記載の撮像用半導体装置であって、前記遮光板は前記基板の開口内において前記レンズ取り付け部から前記半導体チップに向かって延在していることを特徴とするものである。

【0021】請求項4記載の発明によれば、レンズ取り付け部の一部として遮光板を形成することができ、容易に受光素子に対する遮光効果を得ることができる。

【0022】請求項5記載の発明は、請求項4記載の撮像用半導体装置であって、前記遮光板は弾性を有する材料で形成されており、先端が前記半導体チップの前記回路形成面に当接していることを特徴とするものである。

【0023】請求項5記載の発明によれば、遮光板が半導体チップの回路形成面に当接することにより、基板を透過する光を遮光板により完全に遮断することができる。また、遮光板が回路形成面に当接しても、遮光板は弾性変形するため、回路形成面の損傷を与えることはない。

6

【0024】請求項6記載の発明は、請求項2記載の撮像用半導体装置であって、前記遮光板は前記レンズ取り付け部に一体的に形成されており、前記遮光板の先端は前記半導体チップの前記回路形成面に接着剤により固定されていることを特徴とするものである。

【0025】請求項6記載の発明によれば、遮光板を介してレンズ取り付け部を半導体チップの回路形成面に直接固すことができる。したがって、受光素子への周囲からの光の影響を排除すると共に、基板の厚みのばらつきによる撮像用レンズと受光素子との間の距離への影響を排除することができる。

【0026】請求項7記載の発明は、請求項1乃至6のうちいずれか一項記載の撮像用半導体装置であって、前記レンズ取り付け部は前記撮像用レンズに対する絞りとして作用する開口を形成する絞り部を有しており、該開口を形成する前記絞り部の端部は前記撮像用レンズの光軸に対して所定角度傾斜した傾斜面であることを特徴とするものである。

【0027】請求項7記載の発明によれば、絞り部の端面により反射された光が受光素子に入射することを防止することができ、画像の劣化を防止することができる。

【0028】請求項8記載の発明は、請求項1乃至7のうちいずれか一項記載の撮像用半導体装置であって、前記基板は外部回路に接続されるための配線引き出し部を有しており、該配線引き出し部に電子部品が搭載されていることを特徴とするものである。

【0029】請求項8記載の発明によれば、配線引き出し部に電子部品を搭載することにより、スペースを有効に利用することができ、実装密度を向上することができる。

【0030】請求項9記載の発明は、撮像用レンズが取り付けられたレンズ取り付け部と、前記撮像用レンズからの光を画像信号に変換する受光素子が形成された半導体チップと、前記半導体チップが実装された基板とを有する撮像用半導体装置であって、前記レンズ取り付け部は、前記撮像用レンズが取り付けられた上側部分と、前記基板に固定された下側部分とを有し、前記上側部分は前記下側部分に対して前記基板に接近又は離間する方向に移動可能に構成されており、前記撮像用レンズと前記半導体チップとの間の距離は可変であることを特徴とするものである。

【0031】請求項9記載の発明によれば、撮像用レンズと半導体チップとの間の距離が変更することにより、撮像用レンズの焦点が常に受光素子に一致するように調整することができる。これにより、常に焦点の合った画像を得ることができる。

【0032】請求項10記載の発明は、請求項9記載の撮像用半導体装置であって、前記上側部分が前記基板から離間する方向に移動した際に、前記上側部分が前記下側部分から外れないように抜け止め機構が設けられたこ

(5)

7

とを特徴とするものである。

【0033】請求項9記載の発明によれば、撮像用レンズと半導体チップとの間の距離が変更することにより、撮像用レンズの焦点が常に受光素子に一致するように調整することができる。これにより、常に焦点の合った画像を得ることができる。

【0034】請求項10記載の発明によれば、レンズが設けられた上側部分が下側部分から外れないように抜け止め機構が設けられることにより、例えば装置の振動により、上側部分の螺子接続部緩んで外れてしまうことを防止できる。

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について図面と共に説明する。

【0035】図1(a)は本発明の第1実施例による撮像用半導体装置の断面図であり、図1(b)は図1

(a)に示す半導体チップの受光面の平面図である。本発明の第1実施例による撮像用半導体装置10は、固体撮像用半導体チップ12と、TABテープ基板14と、レンズ取り付け部16とによりなる。

【0036】半導体チップ12はTABテープ基板14に上にフリップチップ実装される。レンズ取り付け部16は、レンズ(対物レンズ)18を含む光学システムを構成しており、TABテープ基板14に対して、半導体チップ12の反対側に搭載される。すなわち、半導体チップ12とレンズ取り付け部16とは、TABテープ基板14を挟んでその両側に搭載される。

【0037】半導体チップ12の回路形成面(受光面)12aには、撮像用の受光素子としてC-MOSセンサが形成されている。半導体チップ12は、回路形成面12aをTABテープ基板14に向けた状態で、TABテープ基板14に対してフリップチップ実装される。

【0038】TABテープ基板14には、半導体チップ12の回路形成面12aに形成されたC-MOSセンサ(受光素子)に対応する位置に開口14aが設けられている。したがって、半導体チップ12がTABテープ基板14に実装された状態で、半導体チップ12のC-MOSセンサは、TABテープ基板14の開口14a内に位置することとなる。

【0039】TABテープ基板14はポリイミドテープ14Aに配線14Bが形成されたものである。配線14Bはポリイミドテープ14Aに銅箔を貼り付けて、銅箔をパターン形成することにより形成される。半導体チップ12には外部接続用端子としてバンプ12bが形成されている。バンプ12bは、TABテープ基板14の配線14Bの一部として形成されたボンディングパッドに異方性導電樹脂20により接合される。なお、ポリイミドテープ14Aはこれに限られることなく、適當な柔軟性を有する材料、例えばポリエスチルテープとしてもよい。また、配線14Bを形成する材料は銅箔に限られることなく、例えばアルミ箔等を用いることとしてもよ

8

い。

【0040】レンズ取り付け部16の本体16Aは、中央部に貫通した開口を有しており、この開口の上部を覆う状態でレンズ18が設けられている。レンズ18は本体16Aの開口の上部にはめ込まれ、レンズ押さえ蓋22により固定される。レンズ押さえ蓋22は接着剤24により本体16Aに固定される。

【0041】レンズ取り付け部16は、本体16Aの開口がTABテープ基板14の開口14aに一致した状態で、TABテープ基板14に対して接着剤26により固定される。本体16Aには位置決め用ピン28が設けられており、レンズ取り付け部16の本体16Aは、位置決め用ピン28がTABテープ基板14に設けられた位置決め孔14bに嵌合することにより、正確に位置決めされる。

【0042】TABテープ基板14に設けられた位置決め孔14bは、配線パターン用の位置決め孔を基準としてエッチング等により形成されるため、配線パターンに対して高い位置精度で形成される。したがって、位置決め孔14bに位置決めピン28を嵌合することにより、レンズ取り付け部16はTABテープ基板14に対して高い位置精度で取り付けられる。

【0043】レンズ取り付け部16の本体16Aの開口のレンズ18の下側には、絞り部30が形成されている。また、絞り部30の更に下側にはIRフィルタ32が配置されている。

【0044】上述のような構成において、レンズ18により集光された光は、絞り部30及びIRフィルタ32を通過して、半導体チップ12の回路形成面12aに形成されたC-MOSセンサに入射する。レンズ18と回路形成面12aとの間の距離は、レンズ18の焦点距離に等しくなるように設定されている。したがって、レンズ18に入射した光は、C-MOSセンサ上に集光され結像する。

【0045】そして、C-MOSセンサ上の像はC-MOSセンサにより電気信号に変換され、画像信号としてTABテープ基板14の配線引出し部14cを介して外部装置に供給される。

【0046】図2(a)は上述のTABテープ基板14の平面図である。図2(b)は図2(a)に示すTABテープ基板14と比較するための例を示す図であり、半導体チップ12をワイヤボンディングにより基板に搭載する場合の基板の平面図である。

【0047】図2(b)に示す基板40では、半導体チップ12の周囲にワイヤボンディング用のパッド42を設け、半導体チップ12の電極をボンディングワイヤ44によりパッドに電気的に接続する。したがって、半導体チップ12の周囲には、パッド42を設ける領域が必要である。

【0048】一方、図2(a)に示すTABテープ基板

(6)

9

14では、半導体チップ12はフリップチップ実装されるため、TABテープ基板14のパッドは半導体チップ12の電極に重なる位置となる。このように、パッドを設ける領域は半導体チップ12の内側となり、図2

(b)に示す例のようにパッドを設ける領域を半導体チップ12の周囲に設ける必要はない。したがって、図2(a)に示す本実施例によるTABテープ基板14の面積(外形寸法)は、図2(b)に示す例の基板より小さくすることができ、撮像用半導体装置10の全体寸法も小さくすることができる。

【0049】図3は図1(a)に示す撮像用半導体装置10を外部回路に接続した例を示す図である。撮像用半導体装置10は、例えば携帯電話機に組み込まれる場合、携帯電話機内に設けられたプリント基板50に接続される。具体的には、撮像用半導体装置10のTABテープ基板14の配線引き出し部14cは、プリント基板50の配線52にハンダ54により接続される。

【0050】ここで、TABテープ基板14はポリイミド等の柔軟性を有する材料で形成されているため、半田接続後にTABテープ基板14を自由に折り曲げることができる。図3に示す例では、TABテープ基板14を屈曲して撮像用半導体装置10をプリント基板50の上方に配置している。このように、柔軟性を有するTABテープ基板14を用いることにより、撮像用半導体装置10が組み込まれる機器(ここでは携帯電話機)の筐体設計に自由度を持たせることができる。

【0051】TABテープ基板14の代わりに柔軟性を有しない基板を使用した場合は、撮像用半導体装置10と、プリント基板50との間にフレキシブル基板を設けて接続することにより、撮像用半導体装置10の位置の自由度は増す。しかし、フレキシブル基板を取り付ける分だけ余分な面積が必要となり、製造工程も複雑となってしまう。

【0052】図4は図1(a)におけるA部の拡大図である。レンズ取り付け部16の本体の底面には、遮光板60が形成されている。遮光板60は、レンズ取り付け部16がTABテープ基板14に搭載された際に、TABテープ基板14の開口14aの内面を全周にわたって覆うように設けられる(図1(b)参照)。

【0053】図5は遮光板60の作用を説明するための図であり、図5(a)は遮光板60を設けていない状態を示し、図5(b)は遮光板60を設けた状態を示す。

【0054】遮光板60が設けられていない場合、図5(a)に示すように、TABテープ基板14のポリイミドテープ14Aを透過した光(図中、矢印で示す)が開口14a内に入射してしまう。すなわち、柔軟性を有する基板するために、ポリイミドテープあるいはポリエチレンテープ等の樹脂テープを使用すると、これらのテープは比較的光を透過しやすいので、TABテープ基板14の開口14a内に光が入ってしまう。開口14a内

10

に入った光の一部は半導体チップ12の受光部12c(C-MOSセンサ)に入射し、ハレーションを発生して画像を劣化させる。

【0055】しかし、本実施例では、図1(b)及び図5(b)に示すように、遮光板60により開口14aの内面が覆われているので、ポリイミドテープ14Aを透過してきた光(図中、矢印で示す)は遮光板60により遮られて、半導体チップ12の受光部12cには到達しない。したがって、遮光板60を設けることにより、TABテープ基板14を透過してくる光に起因したハレーションの発生を防止することができ、画像の劣化を防ぐことができる。

【0056】なお、遮光板60と半導体チップの回路形成面(受光面)との間には僅かな間隙が形成され、その間隙から光が漏れることははあるが、この漏れる光の量は非常に僅かであり、受光面に対して実質的に影響を及ぼさない。

【0057】図6は遮光板60の変形例を示す断面図である。図6に示す遮光板62は、弾性を有する材料で作成されており、レンズ取り付け部16の本体16Aに取り付けられている。取り付け方法は、遮光板62の一部を受容する嵌合部を本体16Aに形成しておき、遮光板62をはめ込んで固定することとしてもよく、また、接着剤等で固定してもよい。

【0058】遮光板62が本体16Aの底面から突出する寸法は、本体16Aの底面から半導体チップ12の回路形成面12aまでの距離より僅かに大きくしておく。これにより、レンズ取り付け部16と半導体チップ12とがTABテープ基板14に搭載された状態で、遮光板62は半導体チップ12の回路形成面12aに当接し、遮光板62と回路形成面12aの間には間隙が形成されない。したがって、TABテープ14を透過した光は遮光板62により完全に遮断され、開口14a内の受光面に到達することはない。なお、遮光板62は弾性を有する材料で形成されるので、遮光板62が回路形成面12aに当接しても弾性変形し、回路形成面12aに損傷を与えることはない。

【0059】図7は遮光板を含めたレンズ取り付け部16の取り付け構造の変形例を示す断面図である。図7に示す変形例では、遮光板64はレンズ取り付け部16の本体16Aの一部として比較的大きな厚みを有している。そして、本体16Aは遮光板64を介して導体チップの回路形成面12aに接着剤66により固定されている。すなわち、レンズ取り付け部16は、TABテープ基板14に搭載されるのではなく、半導体チップ12に固定される。

【0060】図7に示すような取り付け構造によれば、光学系を構成するレンズ取り付け部16をTABテープ基板14から分離しておくことができる。これにより、レンズ取り付け部16に作用する外力がTABテープ基

(7)

11

板14に直接作用することを防止することができる。

【0061】例えば、本実施例による撮像用半導体装置10が携帯電話機に組み込まれた場合、レンズ取り付け部16は携帯電話機の筐体に取り付けられる。この取り付けの際、レンズ取り付け部16には外力が作用し、この外力がTABテープ基板14のような電気信号に係る部分に作用すると電気的な部分に不良が発生し信頼性が低下することがある。

【0062】しかし、図7に示す例では、レンズ取り付け部16の本体16AはTABテープ基板14に接触していないので、上述のようなレンズ取り付け部16に作用する外力に起因した問題は生じない。また、本体16Aに一体的に形成された遮光板64が接着剤66により半導体チップ12の回路形成面12aに固定されるため、TABテープ基板14を透過してきた光も完全に遮断することができる。

【0063】図8は図1のB部の拡大図である。図8に示すように、本実施例における絞り部30の先端部分には、レンズの光軸に対して所定の角度θだけ傾斜した傾斜面30aが設けられている。図9は傾斜面30aが設けられていない場合の、光の経路を示す図であるが、この場合、レンズ18を透過して絞り部30の端面に到達した光は、端面により反射されて受光面に入射し、画像の劣化の原因となる。そこで、本実施例では、レンズの光軸に対して所定の角度θ傾斜した傾斜面30aを設けることにより、レンズを透過してきた光が絞り部30の端面で反射して受光面に到達しないように構成されている。

【0064】次に本発明の第2実施例について図10を参照しながら説明する。図10は本発明の第2実施例による撮像用半導体装置70の断面図である。なお、図10において、図1に示す構成部品と同等な部品には同じ参照符号を付し、その説明は省略する。

【0065】本発明の第2実施例による撮像用半導体装置では、TABテープ基板14のポリイミドテープ14Aに、半導体チップ12が入るような開口を予め形成しておく。また、銅箔等をエッチングによりパターン形成した配線14Bに対して錫メッキを施しておく。そして、半導体チップ12のバンプ12bを金バンプとして形成し、金バンプ12bと配線14BとをILB接続

(金錫共晶接続)により接合する。金バンプ12bと配線14Bとを接続した後、充填樹脂72を金バンプ12bの接合部付近にポッティングして充填する。そしてレンズ取り付け部16を充填樹脂72の上に配置して接着剤26により固定する。

【0066】本実施例によれば、TABテープ基板14を上述の第1実施例とは反対向きで用いており、レンズ取り付け部16と半導体チップ12との間にTABテープ基板14のポリイミドテープ14Aが介在していない。したがって、ポリイミドテープ14Aの厚さにばらつきがある場合、レンズ18と半導体チップ12との間の距離は一定に保たれる。また、レンズ取り付け部16は半導体チップ12の回路形成面12aに直接接着されているため、レンズ取り付け部16と半導体チップ12との間に隙間が形成されることなく、半導体チップ12の受光面に不要な光が入射することを防止できる。

12

つきがあっても、レンズ18と半導体チップ12との間の距離は一定に保たれる。また、ポリイミドテープ14Aを透過する光を遮光するための遮光部を設ける必要はない。

【0067】次に本発明の第3実施例について図11を参照しながら説明する。図11は本発明の第3実施例による撮像用半導体装置80の断面図である。なお、図11において、図1に示す構成部品と同等な部品には同じ参照符号を付し、その説明は省略する。

【0068】本発明の第3実施例による撮像用半導体装置では、TABテープ基板14のポリイミドテープ14Aに、半導体チップ12が入るような開口を予め形成しておく。また、銅箔等をエッチングによりパターン形成した配線14Bに対して金メッキを施しておく。そして、金メッキが施された配線14Bと半導体チップ12のバンプ12bとを、シングルポイントボンディングで接続する。バンプ12bと配線14Bとを接続した後、充填樹脂72を金バンプ12bの接合部付近にポッティングして充填する。そして図7に示すような構成のレンズ取り付け部16を半導体チップ12の回路形成面12a上に配置して接着剤66にて固定する。

【0069】本実施例によれば、TABテープ基板14を上述の第1実施例とは反対向きで用いており、レンズ取り付け部16と半導体チップ12との間にTABテープ基板14のポリイミドテープ14Aが介在していない。したがって、ポリイミドテープ14Aの厚さにばらつきがあっても、レンズ18と半導体チップ12との間の距離は一定に保たれる。また、レンズ取り付け部16は半導体チップ12の回路形成面12aに直接接着されているため、レンズ取り付け部16と半導体チップ12との間に隙間が形成されることなく、半導体チップ12の受光面に不要な光が入射することを防止できる。

【0070】次に本発明の第4実施例について図12を参照しながら説明する。図12は本発明の第4実施例による撮像用半導体装置90の断面図である。なお、図12において、図1に示す構成部品と同等な部品には同じ参照符号を付し、その説明は省略する。

【0071】図12に示す撮像用半導体装置90は、基本的に図1に示す撮像用半導体装置10と同じ構成を有するが、レンズ取り付け部16の本体16Aが、上側部分16A-1と下側部分16A-2とに分割されていることが異なる。また、本実施例では、TABテープ基板14の配線引き出し部14cに実装部品92を搭載して半田付けし、配線引き出し部14cを有効利用して、高密度の実装を実現している。

【0072】上側部分16A-1にはレンズ18が取り付けられ、下側部分16A-2には絞り部30、IRフィルタ32及び遮光板60が設けられる。そして、上側部分16A-1と下側部分16A-2とは互いに螺子接続されており、上側部分16A-1を下側部分16A-

(8)

13

2から分離することができる。すなわち、光学系におけるレンズ18を撮像用半導体装置90から取り外すことができる構成となっている。

【0073】実装部品92をTABテープ基板14に半田付けする際、半田リフローにより搭載するが、レンズ18はプラスチックレンズであるため、半田リフロー時の熱でプラスチックレンズが損傷を受けるおそれがある。そこで、本実施例では、レンズ18を含む上側部分16A-1を半田リフロー時に撮像用半導体装置90から取り外しておきことができる。半田リフローが終了した後に上側部分16A-1を下側部分16A-2に螺子接続することにより、レンズ18を容易に組み込むことができる。

【0074】また、本実施例及び、上述の実施例では必要ないが、レンズ18と半導体チップ12の回路形成面(受光面)12aと間の距離を可変とすることもできる。すなわち、上側部分16A-1を下側部分16A-2に対して回転することにより、レンズ18の位置は下方向に移動し、レンズ18と回路形成面12aとの間の距離を変えることができる。

【0075】図13は、上側部分16A-1と下側部分16A-2の螺子接続部分を拡大して示す断面図である。螺子接続は、振動等により螺子部がゆるんで回転してしまい、レンズ18と半導体チップ12との間の距離が変わってしまったり、上側部分16A-1が外れてしまったりするおそれがある。

【0076】そこで、本実施例では、上側部分16A-2の抜け止めや回り止めを施すことで、上述の不具合に対処している。まず、抜け止めについて図14乃至17を参照しながら説明する。

【0077】図14は下側部分16A-2の螺子接続部分の斜視図である。螺子接続部分の先端部には直径方向上対向した部分に一対の突起部92が設けられる。各突起部92は、縦方向に設けられた一対の切り込み溝(スリット)94の間に設けられる。切り込み溝94の間の部分は、直径方向に外力が作用した場合に、容易に弾性変形できる程度の幅とされている。

【0078】図15は突起部92が設けられた部分の拡大断面図である。突起部92が設けられる部分は、その半径方向の厚みも小さくされており、半径方向に容易に弾性変形可能となっている。突起部92は螺子接続部よりも半径方向上外側に突出している。突起部92の上端面には適当な傾斜が設けられており、上側部分16A-1の螺子接続部が下側部分16A-2の螺子接続部分にねじ込まれる際に、容易に半径方向内側へ弾性変形することができる。すなわち、突起部92の上端面に上側部分16A-1の螺子接続部を押圧することにより、突起部92は半径方向内側に弾性変形して、上側部分16A-1の螺子接続部を容易に下側部分16A-2の螺子接続部にねじ込むことができる。

(8)

14

【0079】上側部分16A-1の螺子接続部が下側部分16A-2の螺子接続部にねじ込まれると、弾性変形していた突起部92は元の位置に戻る。したがて、上側部分16A-1が取り外す方向に移動した際に、その螺子接続部は突起部92の下端面に当接する。これにより、例えば振動により上側部分が回転して外れる方向に移動したような場合は、突起部92の下端面によりそれ以上の移動が防止される。したがって、突起部92の下端面は、上側部分16A-1の抜け止めとして作用する。

【0080】ただし、上側端部16A-1を取り外したい場合は、強制的に上側部分16A-1を外す方向に回すことにより、突起部92は半径方向内側に弾性変形して、上側部分16A-1の螺子接続部の移動を許容する。すなわち、突起部92は、振動等による小さな回転力が上側部分16A-1に作用した場合は抜け止めとして作用し、大きな回転力が作用した場合は上側部分の移動を許容する。

【0081】図16は突起部92の他の例を示す断面図である。図16(a)に示す突起部92Aは、その上端面と下端面が丸みを帯びており、上側部分16A-1の螺子接続部が突起部92A上を滑らかに滑動可能となっている。

【0082】また、図16(b)に示す突起部92Bは、その上端面は丸みを帯びているが、下端面は直角に切れ込んでいる。突起部92Bの形状によれば、上側部分16A-1の螺子接続部は、容易に下側部分の螺子接続部分にねじ込むことはできるが、一旦ねじ込まれた後は、上側部分16A-1に大きな回転力が作用したとしても接続部の移動は突起部92Bの下端面により阻止される。

【0083】図17は上側部分の抜け止めの他の例を示す断面図である。図17に示す例では、下側部分16A-2の螺子接続部の先端部の外周に溝96を設け、溝96内に抜け止め用のリング98を配置している。リング98は、図17(b)に示すように、一部が除去された円形状であり、弾性を有する金属ワイヤあるいは樹脂により形成される。

【0084】リング98は、図17(a)に示すように、断面の略半分が溝96から外側に出るような円形に形成されている。リング98は予め溝96にはめ込まれており、上側部分16A-1の螺子接続部がねじ込まれる際に、内側に圧縮されてその径が小さくなる。すなわち、リング98は溝96内に収容されたれた状態となり、上側部分16A-1の螺子接続部は容易にリング98の部分を通過することができる。

【0085】上側部分16A-1の螺子接続部がリング98の部分を通過してしまうと、リング98は元の形状に戻り、図17(a)に示す状態となる。したがって、上側部分16A-1が外れる方向に移動しても、リング

(9)

15

9 8 が抜け止めとして作用して、上側部分 1 6 A - 1 は、リング 9 8 を超えて移動することができない。

【0 0 8 6】なお、リング 9 8 を形状記憶合金で形成し、上側部分をねじ込んだ後に、リング 9 8 を加熱して元の形状に戻すこととしてもよい。すなわち、リング 9 8 の形状を図 1 7 (a) に示す状態として記憶させておき、溝 9 6 にはめ込むときは径を小さくしておく。すなわち、リング 9 8 は最初は小さい径として溝 9 6 に全体が入り込むようにしておく。そして、上側部分 1 6 A - 1 がねじ込まれた後にリング 9 8 を加熱して元の形状に戻す。すなわち、上側部分 1 6 A - 1 がねじ込まれた後にリング 9 8 を加熱して図 1 7 (a) に示す状態とすることにより、リング 9 8 は抜け止めとして作用する。

【0 0 8 7】図 1 8 は、上側部分と下側部分との間に回り止めを設けた例を示す断面図である。図 1 8 に示す例では、上側部分 1 6 A - 1 の螺子接続部に溝 1 0 0 を設け、溝 1 0 0 内に、ゴム等の弾性材料の○リング 1 0 2 を設けている。○リング 1 0 2 が下側部分 1 6 A - 2 の螺子接続部の上端部の外周面に当接するように、溝 1 0 0 の形状及び○リングの形状を設定する。これにより、上側部分 1 6 A - 1 の螺子接続部がある程度ねじ込まれた時点で、○リング 1 0 2 が下側部分 1 6 A - 2 の螺子接続部に接触する。その後、○リング 1 0 2 が弾性変形した状態で、上側部分 1 6 A - 1 を更にねじ込む。これにより、上側部分 1 6 A - 1 の螺子接続部と下側部分 1 6 A - 2 との間には、○リング 1 0 2 が弾性変形した状態で設けられることとなり、○リング 1 0 2 の摩擦により上側部分 1 6 A - 1 容易に回らない状態となる。これにより、振動等により上側部分 1 6 A - 1 が回転してレンズ 1 8 と受光面との間の距離が変化してしまうことを防止できる。

【発明の効果】上述の如く本発明によれば、次に述べる種々の効果を実現することができる。請求項 1 記載の発明によれば、半導体チップを実装するための基板は半導体チップの回路形成面と撮像用レンズとの間に配置される。これにより、基板の厚みを撮像用レンズと半導体装置の回路形成面に形成された受光素子との間の距離、すなわち撮像用レンズの焦点距離内に配置することができる。したがって、撮像用半導体装置の厚みは、実質的に撮像用レンズの焦点距離と半導体チップの厚みとの和に等しくなる。すなわち、基板の厚さは装置全体の厚みに含まれないため装置全体の厚みを減少することができる。また、柔軟性を有する基板は光を透過する特性を有しているが、遮光板を設けることにより基板を通過してきた光を遮断して受光素子への影響を実質的に排除することができ、画質の劣化を防止することができる。

【0 0 8 8】請求項 2 記載の発明によれば、基板に開口が形成されているため、フリップチップ実装等により半導体チップを基板に実装しても回路形成面に形成された受光素子を、開口を介して基板の反対側に取り付けられた

16

撮像用レンズに対向させることができる。また、半導体チップを基板に実装する際に、半導体チップの回路形成面の反対側の背面を支持することができるため、回路形成面を画像認識しながら実装を行うことができる。これにより、半導体チップを高い位置精度で基板に実装することができる。

【0 0 8 9】請求項 3 記載の発明によれば、基板に形成された位置決め孔にレンズ取り付け部の位置決めピンを嵌合することにより、レンズ取り付け部を高い位置精度で基板に取り付けることができる。半導体チップも基板に対して高い位置精度で実装することができるため、撮像用レンズと半導体チップとを高い位置精度で組み立てることができる。

【0 0 9 0】請求項 4 記載の発明によれば、レンズ取り付け部の一部として遮光板を形成することができ、容易に受光素子に対する遮光効果を得ることができる。

【0 0 9 1】請求項 5 記載の発明によれば、遮光板が半導体チップの回路形成面に当接することにより、基板を透過する光を遮光板により完全に遮断することができる。また、遮光板が回路形成面に当接しても、遮光板は弾性変形するため、回路形成面の損傷を与えることはない。

【0 0 9 2】請求項 6 記載の発明によれば、遮光板を介してレンズ取り付け部を半導体チップの回路形成面に直接固すことができる。したがって、受光素子への周囲からの光の影響を排除すると共に、基板の厚みのばらつきによる撮像用レンズと受光素子との間の距離への影響を排除することができる。

【0 0 9 3】請求項 7 記載の発明によれば、絞り部の端面により反射された光が受光素子に入射することを防止することができ、画像の劣化を防止することができる。

【0 0 9 4】請求項 8 記載の発明によれば、配線引き出し部に電子部品を搭載することにより、スペースを有効に利用することができ、実装密度を向上することができる。

【0 0 9 5】請求項 9 記載の発明によれば、撮像用レンズと半導体チップとの間の距離が変更することにより、撮像用レンズの焦点が常に受光素子に一致するように調整することができる。これにより、常に焦点の合った画像を得ることができる。

【0 0 9 6】請求項 10 記載の発明によれば、レンズが設けられた上側部分が下側部分から外れないように抜け止め機構が設けられることにより、例えば装置の振動により上側部分の螺子接続部緩んで外れてしまうことを防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 (a) は本発明の第 1 実施例による撮像用半導体装置の断面図であり、(b) は半導体チップの受光面の平面図である。

【図 2】 (a) は図 1 に示す TAB テープ基板の平面図

(10)

17

であり、(b) は半導体チップをワイヤボンディングする場合のプリント基板の平面図である。

【図3】図1(a)に示す撮像用半導体装置を機器に組み込むための構成を示す図である。

【図4】図1(a)のA部の拡大図である。

【図5】図1に示す遮光板の作用を説明するための断面図である。

【図6】遮光板の変形例を示す断面図である。

【図7】遮光板を介してレンズ取り付け部の本体と半導体チップとを接続する例を示す断面図である。

【図8】図1に示すB部の拡大図である。

【図9】絞り部により反射される光の光路を説明するための図である。

【図10】本発明の第2実施例による撮像用半導体装置の断面図である。

【図11】本発明の第3実施例による撮像用半導体装置の断面図である。

【図12】本発明の第4実施例による撮像用半導体装置の断面図である。

【図13】図12に示す螺子接続部付近の拡大断面図である。

【図14】図12に示す下側部分の螺子接続部に設けられる突起部の斜視図である。

【図15】図14に示す突起部の断面図である。

【図16】図15に示す突起部の変形例を示す断面図である。

【図17】螺子接続部に設けられる抜け止めの他の例を

18

示す断面図である。

【図18】螺子接続部に設けられる回り止めを示す断面図である。

【符号の説明】

10, 70, 80, 90 撮像用半導体装置

12 半導体チップ

12a 回路形成面

12b バンプ

12c 受光部

14 TABテープ基板

14A ポリイミドテープ

14B, 52 配線

14a 開口

14b 位置決め孔

14c 配線引き出し部

16 レンズ取り付け部

16A 本体

16A-1 上側部分

16A-2 下側部分

20 異方性導電樹脂

22 レンズ押さえ蓋

24, 26 接着剤

30 絞り部

32 IRフィルタ

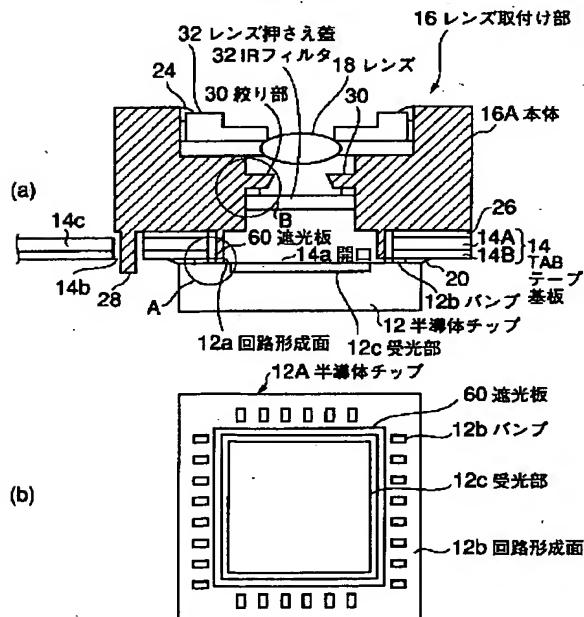
50 プリント基板

54 半田

60, 62, 64 遮光板

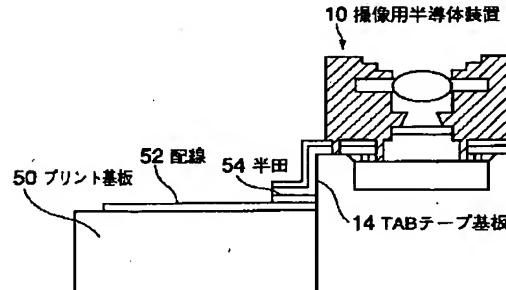
【図1】

本発明の第1実施例による撮像用半導体装置の断面図



【図3】

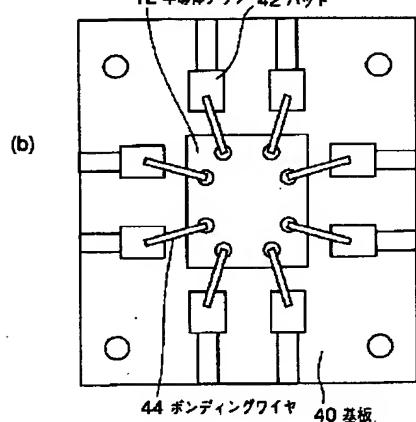
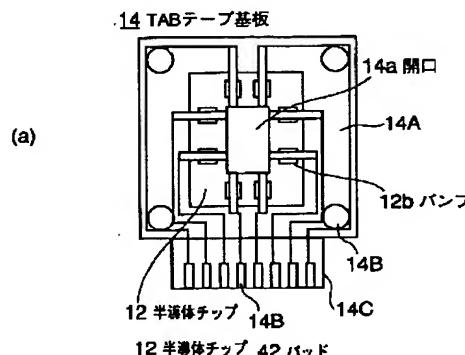
図1に示す撮像用半導体装置を機器に組み込むための構成を示す図



(11)

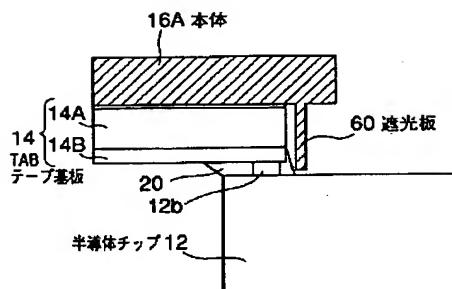
【図2】

(a)は図1に示すTABテープ基板の平面図であり、(b)は半導体チップをワイヤボンディングする場合のプリント基板の平面図



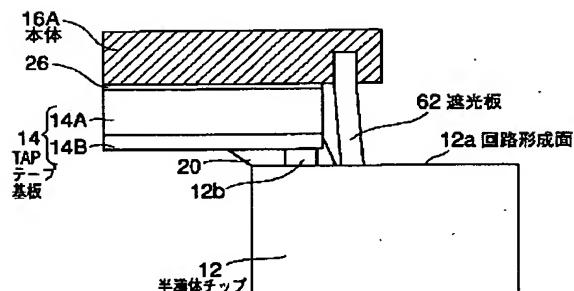
【図4】

図1のA部の拡大図



【図6】

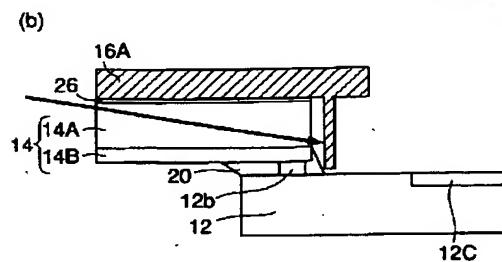
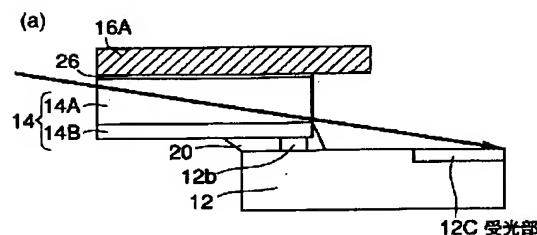
遮光板の変形例を示す断面図



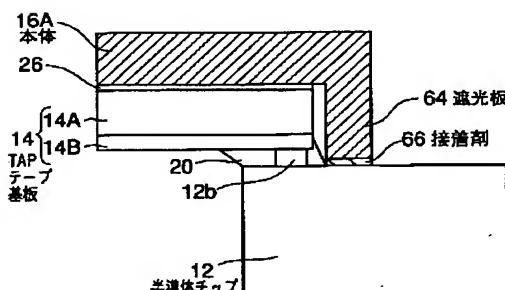
【図7】

【図5】

図1に示す遮光板の作用を説明するための断面図



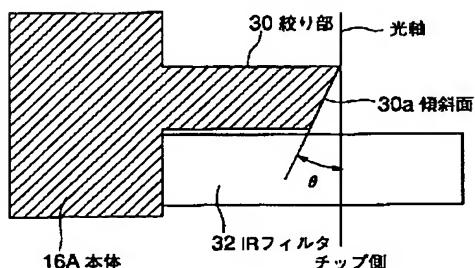
遮光板を介してレンズ取り付け部の本体と半導体チップとを接続する例を示す断面図



(12)

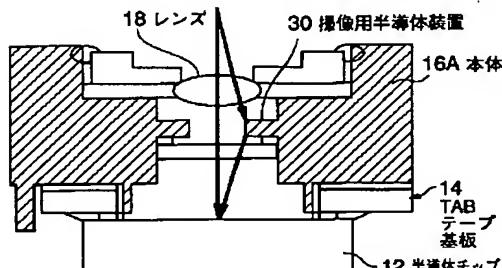
【図 8】

図1に示すB部の拡大図



【図 9】

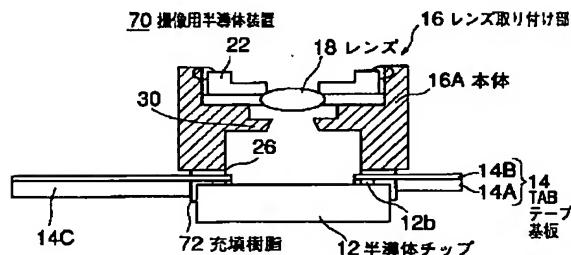
絞り部により反射される光の光路を説明するための図



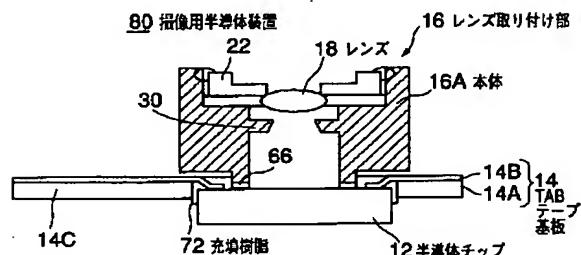
【図 10】

【図 11】

本発明の第2実施例による撮像用半導体装置の断面図



本発明の第3実施例による撮像用半導体装置の断面図



【図 12】

【図 13】

本発明の第4実施例による撮像用半導体装置の断面図

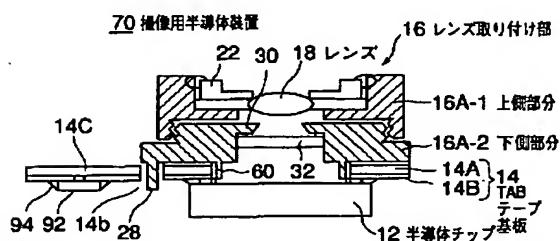
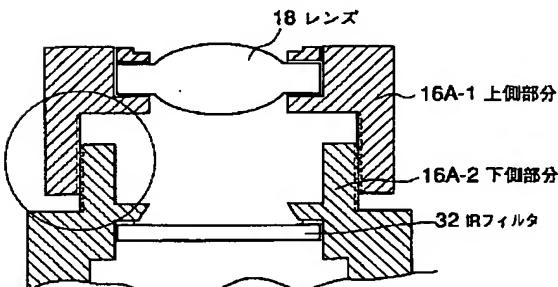
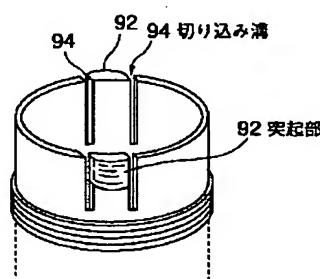


図12に示す蝶子接続部付近の拡大断面図



【図 14】

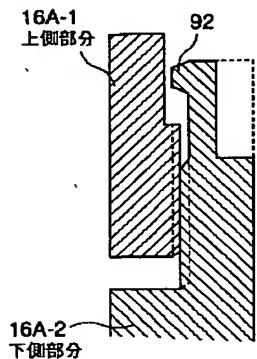
図12に示す下側部分の蝶子接続部に設けられる突起部の斜視図



(13)

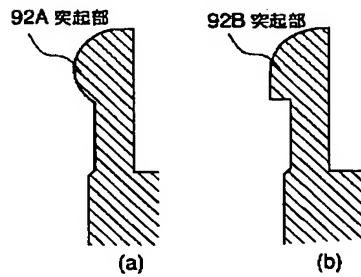
【図15】

図14に示す突起部の断面図



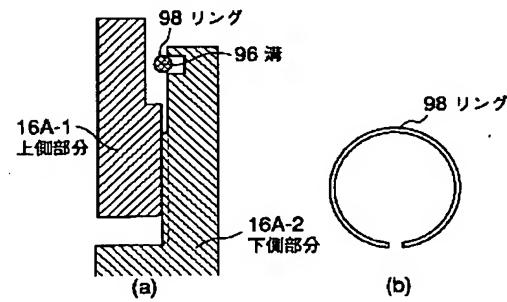
【図16】

図15に示す突起部の変形例を示す断面図



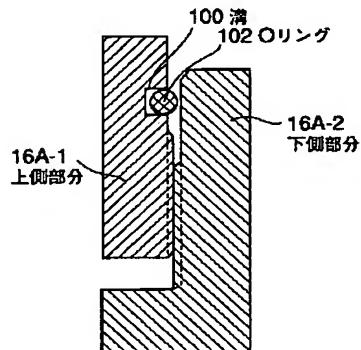
【図17】

蝶子接続部に設けられる抜け止めの他の例を示す断面図



【図18】

蝶子接続部に設けられる回り止めを示す断面図



フロントページの続き

(72) 発明者 鈴木 英雄

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
1号 富士通株式会社内

F ターム (参考) 4M118 AA10 AB01 BA14 GD02 HA23
 HA24 HA27 HA30 HA32
 5C022 AA13 AB43 AC42 AC51 AC54
 AC70 AC78
 5C024 BX01 CY49 EX21 EX25 EX42
 GY31
 5F044 KK03 LL00 NN07 NN08 NN13
 NN18

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.